

# ZACROS Package

## 2008東京国際包装展 出展のご案内

平成20年10月7日(火)～11日(土) 東京ビックサイト  
主催/社団法人 日本包装技術協会

拝啓 新秋の侯、いよいよご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、当社は大正3年(1914年)の創業以来、社会が絶え間なく変化する中で、常に時代のニーズを先取りした技術開発を行ってまいりました。現代は構造変化の時代といわれ、あらゆる産業が激しい変化にさらされています。

そうした激しい環境下において、さらなる発展を続けるためには、一世紀近くにわたって蓄積した技術・ノウハウを礎にお客様により高い付加価値を提供しなければなりません。そのためには、社会の変化やお客様のニーズ以前の漠然とした要望－ウォンツを感じ取り、“時代の求める技術・製品”を提案することが重要になります。

このたび、TOKYO PACK 2008開催にあたり、幅広い産業分野のお客様から確かな信頼を頂いている当社製品を、素材技術、機能性部材、環境対応、開発技術といったカテゴリーにてご紹介いたします。

さらに、お客様とともに“時代の求める技術・製品”づくりに向けたご提案の場として「Package Solution Counter」を設けておりますので、ぜひご活用ください。

ご多忙の折、誠に恐縮ではございますが、ぜひご来場頂けますようお願い申し上げます。

敬具

### 弊社ブースのご案内(東京ビックサイト 東2ホール 2B-08-02)

#### Package Solution Counter

お客様とともに“時代の求める技術・製品”づくりに向けたご提案をいたします。

#### コミュニケーションコーナー

#### 素材技術コーナー

時代が求める高機能な素材技術製品群のご紹介をいたします。

#### 機能性部材コーナー

各種機能フィルムを用いた液体容器のご紹介をいたします。

#### 開発技術コーナー

お客様の要望される商品づくりに向けた表面印刷、加飾技術のご紹介をいたします。

#### 環境対応コーナー

製品づくりににおける環境配慮として事業所で取組むVOC処理システムほかのご紹介をいたします。

#### 受付

製品カタログ配布、アンケートと引き換えにてお配りする粗品も受付にてご対応いたします。

#### 【東2ホール 2B-08-02】

